

報(B2) (12) 特 許 (19)日本国特許庁(JP)

(11)特許番号

第2987140号

(45)発行日 平成11年(1999)12月6日

(24)登録日 平成11年(1999)10月1日

(51) Int.Cl. ⁶	微別記号	FΙ	
H01J 1/30		H01J 1/	30 M
9/02		9/	02 M
19/24		19/	24
21/10	•	21/	10
29/04		29/	04
			請求項の数14(全 16 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平10-272340	(73)特許権者	000005832
			松下電工株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 9月25日		大阪府門真市大字門真1048番地
		(72)発明者	菰田 卓哉
(65)公開番号	特開平11-329213		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工
(43)公開日	平成11年(1999)11月30日		株式会社内
審查請求日	平成10年(1998)10月5日	(72)発明者	越田 信義
(31)優先権主張番号	特顯平9-297108		東京都小平市上水本町6-5-10-203
(32)優先日	平 9 (1997)10月29日	(74)代理人	弁理士 西川 髙清 (外1名)
(33)優先権主張国	日本(JP)		
(31)優先権主張番号	特顯平10-65592	審査官	波多江 進
(32)優先日	平10(1998) 3月16日		
(33)優先権主張国	日本(JP)		
			最終頁に続く

電界放射型電子源およびその製造方法および平面発光装置およびディスプレイ装置および固体真 (54) 【発明の名称】 空デバイス

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に 形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有する多孔 質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に 形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に 対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を 通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のボ リシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グ レインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを 特徴とする電界放射型電子源。

【請求項2】 導電性基板と、導電性基板の一表面側に 形成され窒化されたナノメータ単位の構造を有する多孔 質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に 形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に 対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を

通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のボ リシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グ レインの中心部分では結晶状態が維持されてなることを 特徴とする電界放射型電子源。

【請求項3】 上記多孔質のポリシリコン層は、多孔度 の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン層と が交互に積層された層であることを特徴とする請求項1 または請求項2記載の電界放射型電子源。

【請求項4】 上記多孔質のポリシリコン層は、厚み方 10 向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とす る請求項1または請求項2記載の電界放射型電子源。

【請求項5】 上記多孔質のポリシリコン層は、表面側 に比べて導電性基板側の多孔度が高くなるように厚み方 向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴とす る請求項1または請求項2記載の電界放射型電子源。

3

【請求項6】 上記ポリシリコン層は、ノンドープのボ リシリコン層であることを特徴とする請求項1乃至請求 項5のいずれかに記載の電界放射型電子源。

【請求項7】 導電性基板は、一表面に導電性薄膜が形 成された基板からなることを特徴とする請求項1乃至請 求項6のいずれかに記載の電界放射型電子源。

【請求項8】 請求項1記載の電界放射型電子源の製造 方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成 し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリ シリコン層を酸化し、酸化された多孔質のポリシリコン 10 層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とす る電界放射型電子源の製造方法。

【請求項9】 請求項2記載の電界放射型電子源の製造 方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成 し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリ シリコン層を窒化し、窒化された多孔質のポリシリコン 層上に金属薄膜よりなる電極を形成することを特徴とす る電界放射型電子源の製造方法。

【請求項10】 上記ポリシリコン層の多孔質化にあた っては、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポ 20 リシリコン層とが交互に積層されるように多孔質化の条 件を変化させることを特徴とする請求項8または請求項 9記載の電界放射型電子源の製造方法。

【請求項11】 上記ポリシリコン層の多孔質化にあた っては、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くな り厚み方向に多孔度が連続的に変化するように多孔質化 の条件を変化させることを特徴とする請求項8または請 求項9記載の電界放射型電子源の製造方法。

【請求項12】 請求項1乃至請求項7のいずれかに記 載の電界放射型電子源と、上記金属薄膜に対向配置され 30 る透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光す る蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴と する平面発光装置。

【請求項13】 請求項1乃至請求項7のいずれかに記 載の電界放射型電子源をマトリクス状に構成し、各電界 放射型電子源に印加する上記電圧をそれぞれ制御する手 段と、上記金属薄膜に対向配置される透明電極とを備 え、上記電子線により可視光を発光する蛍光体が上記透 明電極に設けられて成ることを特徴とするディスプレイ 装置。

【請求項14】 少なくとも請求項1乃至請求項7のい ずれかに記載の電界放射型電子源と陽極とが真空容器中 に配設されて成ることを特徴とする固体真空デバイス。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体材料を用い て電界放射により電子線を放射するようにした電界放射 型電子源およびその製造方法、および電界放射型電子源 を利用した平面発光装置およびディスプレイ装置および 固体真空デバイスに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、電界放射型電子源として、例 えば米国特許3665241号などに開示されているい わゆるスピント (Spindt) 型電極と呼ばれるものがあ る。とのスピント型電極は、微小な三角錐状のエミッタ チップを多数配置した基板と、エミッタチップの先端部 を露出させる放射孔を有するとともにエミッタチップに 対して絶縁された形で配置されたゲート層とを備え、真 空中にてエミッタチップをゲート層に対して負極として 高電圧を印加することにより、エミッタチップの先端か ら放射孔を通して電子線を放射するものである。 【0003】しかしながら、スピント型電極は、製造プ ロセスが複雑であるとともに、多数の三角錐状のエミッ タチップを精度良く構成することが難しく、例えば平面 発光装置やディスプレイなどへ応用する場合に大面積化

が難しいという問題があった。また、スピント型電極 は、電界がエミッタチップの先端に集中するので、エミ ッタチップの先端の周りの真空度が低くて残留ガスが存 在するような場合、放射された電子によって残留ガスが プラスイオンにイオン化され、プラスイオンがエミッタ チップの先端に衝突するから、エミッタチップの先端が ダメージ(例えば、イオン衝撃による損傷)を受け、放 射される電子の電流密度や効率などが不安定になった り、エミッタチップの寿命が短くなってしまうという問 題が生じる。したがって、スピント型電極では、この種 の問題の発生を防ぐために、高真空(約10⁻, Pa~約 10-°Pa)で使用する必要があり、コストが高くなる とともに、取扱いが面倒になるという不具合があった。 【0004】この種の不具合を改善するために、MIM (Metal Insulator Metal)方式やMOS (Metal Oxid e Semiconductor)型の電界放射型電子源が提案されて いる。前者は金属-絶縁膜-金属、後者は金属-酸化膜 - 半導体の積層構造を有する平面型の電界放射型電子源 である。しかしながら、このタイプの電界放射型電子源 において電子の放射効率を高めるためには(多くの電子 を放射させるためには)、上記絶縁膜や上記酸化膜の膜 厚を薄くする必要があるが、上記絶縁膜や上記酸化膜の 膜厚を薄くしすぎると、上記積層構造の上下の電極間に 電圧を印加した時に絶縁破壊を起こす恐れがあり、この 40 ような絶縁破壊を防止するためには上記絶縁膜や上記酸 化膜の膜厚の薄膜化に制約があるので、電子の放出効率 (引き出し効率)をあまり高くできないという不具合が

【0005】また、近年では、特開平8-250766 号公報に開示されているように、シリコン基板などの単 結晶の半導体基板を用い、その半導体基板の一表面を陽 極酸化することにより多孔質半導体層(例えば、ポーラ スシリコン層)を形成して、その多孔質半導体層上に金 属薄膜を形成し、半導体基板と金属薄膜との間に電圧を 50 印加して電子を放射させるように構成した電界放射型電

あった。

· . * .- .

子源(半導体冷電子放出素子)が提案されている。 【0006】また、特開平9-259795号公報に は、上記特開平8-250766号公報に開示されてい る構成の電界放射型電子源(半導体冷電子放出素子)を 有する冷電子放出表示装置が提案されている。なお、と の冷電子放出表示装置においては、単結晶シリコン基板 の[100]方向が表面に垂直に配向していることが、 ポーラスシリコン層の電子放出効率の点で好ましいとさ れている。この理由としては、単結晶シリコンの(10 0) 基板を陽極酸化すると、表面から深さ数 µmにわた 10 って孔が形成され、孔およびシリコン結晶が表面に垂直 に配向するからであると推定されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 特開平8-250766号公報に記載の電界放射型電子 源では、基板が半導体基板に限られるので、大面積化や コストダウン化が難しいという不具合がある。また、特 開平8-250766号公報および特開平9-2597 95号公報に記載の電界放射型電子源では電子放出時に いわゆるボッピング現象が生じやすく、放出電子量にむ 20 らが起とりやすいので、平面発光装置やディスプレイ装 置などに応用すると、発光むらができてしまうという不 具合がある。

【0008】本発明は上記事由に鑑みて為されたもので あり、その目的は、電子を安定して高効率で放出できる 低コストの電界放射型電子源およびその製造方法および 平面発光装置およびディスプレイ装置および固体真空デ バイスを提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、上記 30 目的を達成するために、導電性基板と、導電性基板の一 表面側に形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有 する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコ ン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電 性基板に対して正極として電圧を印加することにより金 属薄膜を通して電子線を放射するものであって、上記多 孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化 され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されてな ることを特徴とするものであり、電圧の印加により生じ た熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に 40 放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の 真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象 が発生せず安定して高効率で電子を放出することがで き、また、導電性基板として単結晶シリコン基板などの 半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した 基板などを使用することもできるので、従来のように半 導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合 やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コ スト化が可能になる。

基板の一表面側に形成され窒化されたナノメータ単位の 構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポ リシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄 膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加すること により金属薄膜を通して電子線を放射するものであっ て、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面 が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維 持されてなることを特徴とするものであり、電圧の印加 により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導 して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子 放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッ ビング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出する ことができ、また、導電性基板として単結晶シリコン基 板などの半導体基板の他にガラス基板などに導電性膜を 形成した基板などを使用することもできるので、従来の ように半導体基板を多孔質化した多孔質半導体層を利用 する場合やスピント型電極に比べて、電子源の大面積化 及び低コスト化が可能になる。

【0011】請求項3の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、多 孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低いポリシリコン 層とが交互に積層された層であることを特徴とする。

【0012】請求項4の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、厚 み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴 とする。

【0013】請求項5の発明は、請求項1または請求項 2の発明において、上記多孔質のポリシリコン層は、表 面側に比べて導電性基板側の多孔度が高くなるように厚 み方向に多孔度が連続的に変化した層であることを特徴 とする。

【0014】請求項6の発明は、請求項1乃至請求項5 の発明において、上記ポリシリコン層が、ノンドープの ポリシリコン層なので、酸化または窒化された多孔質の ポリシリコン層が半絶縁性となり、上記電圧を印加する ことにより該多孔質のポリシリコン層が強電界となっ て、導電性基板側から該多孔質のポリシリコン層に注入 された電子がドリフトして該多孔質のポリシリコン層の 表面に達し、ホットエレクトロンとして金属薄膜をトン ネルすることにより電子が放射されるから、上記ポリシ リコン層がドーピングされている場合に比べて高効率で 安定して電子を放出することができ、また、ドーピング が不要なので製造が容易になる。

【0015】請求項7の発明は、請求項1乃至請求項6 の発明において、導電性基板は、一表面に導電性薄膜が 形成された基板からなるので、導電性基板として単結晶 シリコン基板などの半導体基板を用いる場合に比べて大 面積化及び低コスト化が可能になる。

【0016】請求項8の発明は、請求項1記載の電界放 【0010】請求項2の発明は、導電性基板と、導電性 50 射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシ

リコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔 質化されたポリシリコン層を酸化し、酸化された多孔質 のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成する ことを特徴とし、従来のスピント型電極のような複雑な 構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プ ロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コ ストの電界放射型電子源を提供することができ、また、 大面積の電界放射型電子源を提供することができる。

【0017】請求項9の発明は、請求項2記載の電界放 射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシ 10 リコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔 質化されたポリシリコン層を窒化し、窒化された多孔質 のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成する ことを特徴とし、従来のスピント型電極のような複雑な 構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プ ロセスによって電子を安定して高効率で放出できる低コ ストの電界放射型電子源を提供することができ、また、 大面積の電界放射型電子源を提供することができる。

【0018】請求項10の発明は、請求項8または請求 項9の発明において、上記ポリシリコン層の多孔質化に 20 発明を行った。 あたっては、多孔度の高いポリシリコン層と多孔度の低 いポリシリコン層とが交互に積層されるように多孔質化 の条件を変化させることを特徴とする。

【0019】請求項11の発明は、請求項8または請求 項9の発明において、上記ポリシリコン層の多孔質化に あたっては、表面側に比べて導電性基板側の多孔度が高 くなり厚み方向に多孔度が連続的に変化するように多孔 質化の条件を変化させることを特徴とする。

【0020】請求項12の発明は、請求項1乃至請求項 7のいずれかに記載の電界放射型電子源と、上記金属薄 30 膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線によ り可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて 成ることを特徴とするものであり、電界放射型電子源か ら放射される電子の放出角度が金属薄膜の表面に対して 略垂直方向にそろうので、収束電極を設ける必要がな く、構造が簡単になるとともに薄型の平面発光装置を実 現することができる。

【0021】請求項13の発明は、請求項1乃至請求項 7のいずれかに記載の電界放射型電子源をマトリクス状 に構成し、各電界放射型電子源に印加する上記電圧をそ 40 れぞれ制御する手段と、上記金属薄膜に対向配置される 透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する 蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とす るものであり、電界放射型電子源から放射される電子の 放出角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそろう ので、複雑なシャドウマスクや電子収束レンズを設ける 必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現すること ができる。

【0022】請求項14の発明は、少なくとも請求項1

極とが真空容器中に配設されて成ることを特徴とするも のであり、電界放射型電子源が冷陰極を構成するから、 従来の熱電子放射を利用した熱陰極を有する固体真空デ バイスのように加熱手段を設ける必要がなく、小型化が 可能になるとともに陰極物質の蒸発や劣化を抑制するこ とができ、長寿命の固体真空デバイスを実現することが

【0023】ところで、本発明者は、鋭意研究の結果、 従来の技術で説明した特開平8-250766号公報お よび特開平9-259795号公報に記載の構造では、 単結晶シリコン基板などの半導体基板の主表面側を多孔 質化して電子が注入される多孔質層を形成しているので 電界放射型電子源の断熱性が高く、電圧が印加され電流 が流れた場合の基板温度の上昇が比較的大きいという知 見を得た。さらに、該温度上昇により電子が熱的に励起 されるとともに半導体基板の抵抗が下がり、電子の放出 量が増えるので、これにより電子放出時にポッピング現 象が生じやすく、放出電子量にむらが起こりやすいとの 知見を得た。そとで、発明者は、上記知見に基づいて本

[0024]

【発明の実施の形態】(実施形態1)図1に本実施形態 の電界放射型電子源10の概略構成図を、図2(a)~ (e) に電界放射型電子源10の製造方法における主要 工程断面図を示す。なお、本実施形態では、導電性基板 としてη形シリコン基板1(抵抗率が略0.1Ωcmの (100) 基板) を用いている。

【0025】本実施形態の電界放射型電子源10は、図 1 に示すように、n 形シリコン基板 1 の主表面上に急速 熱酸化されたポリシリコン層 5 が形成され、該ポリシリ コン層5上に急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層6 が形成され、該多孔質ポリシリコン層6上に金属薄膜た る金薄膜7が形成されている。また、n形シリコン基板 1の裏面にはオーミック電極2が形成されている。

【0026】ところで、本実施形態では、導電性基板と して n 形シリコン基板 1 を用いているが、導電性基板 は、電界放射型電子源10の負極を構成するとともに真 空中において上述の多孔質ポリシリコン層6を支持し、 なお且つ、多孔質ポリシリコン層6へ電子を注入するも のである。したがって、導電性基板は、電界放射型電子 源10の負極を構成し多孔質ポリシリコン層 6 を支持す ることができればよいので、n形シリコン基板に限定さ れるものではなく、クロムなどの金属基板であってもよ いし、ガラスなどの絶縁性基板の一表面に導電性膜を形 成したものであってもよい。ガラス基板の一表面に導電 性膜を形成した基板を用いる場合には、半導体基板を用 いる場合に比べて、電子源の大面積化および低コスト化 が可能になる。

【0027】また、上述の多孔質ポリシリコン層6は、 乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と陽 50 導電性基板と金属薄膜との間に電圧を印加したときに電

.

子が注入される層である。多孔質ポリシリコン層6は、 多数のグレインよりなる多結晶体であり、各グレインの 表面には酸化膜を有するナノメータ単位の構造(以下、 ナノ構造と称す)が存在する。多孔質ポリシリコン層6 に注入された電子がナノ構造に衝突することなく(つま り、電子散乱することなく)多孔質ポリシリコン層6の 表面に到達するためには、ナノ構造の大きさは、単結晶 シリコン中の電子の平均自由行程である約50nmより も小さいものであることが必要である。ナノ構造の大き しくは5 n mよりも小さいものがよい。なお、本実施形 態では、多孔質ポリシリコン層6は急速熱酸化されてい るが、急速熱酸化に限定されるものではなく、化学的方 法によって酸化してもよく、また、窒化するようにして

もよい。

【0028】また、本実施形態においては、金属薄膜と して金薄膜7を用いているが、金属薄膜は、電界放射型 電子源10の正極を構成するものであり、多孔質ポリシ リコン層6に電界を印加するものである。この電界の印 加により多孔質ポリシリコン層6の表面に到達した電子 20 はトンネル効果によって金属薄膜の表面から放出され る。したがって、導電性基板と金属薄膜との間に印加す る直流電圧によって得られる電子のエネルギから金属薄 膜の仕事関数を差し引いたエネルギが放出される電子の 理想的なエネルギとなるので、金属薄膜の仕事関数は小 さいほど望ましい。なお、本実施形態では、金属薄膜の 材料として金を用いているが、金属薄膜の材料は金に限 定されるものではなく、仕事関数の小さな金属であれば よく、例えば、アルミニウム、クロム、タングステン、 ニッケル、白金などを用いてもよい。ここに、金の仕事 30 関数は5.10eV、アルミニウムの仕事関数は4.2 8eV、クロムの仕事関数は4.50eV、タングステ ンの仕事関数は4.55eV、ニッケルの仕事関数は 5. 15 e V、白金の仕事関数は5. 65 e Vである。 【0029】以下、製造方法を図2を参照しながら説明 する。

【0030】まず、n形シリコン基板1の裏面にオーミ ック電極2を形成した後、n形シリコン基板1の表面に 膜厚が略1.5μmのノンドープのポリシリコン層3を 形成することにより図2(a)に示すような構造が得ら れる。ポリシリコン層3の成膜は、LPCVD法により 行い、成膜条件は、真空度を20Pa、基板温度を64 0℃、モノシランガスの流量を600sccmとした。 なお、ポリシリコン層3の成膜は、導電性基板が半導体 基板の場合にはLPCVD法やスパッタ法により行って もよいし、あるいは、プラズマCVD法によってアモル ファスシリコンを成膜した後にアニール処理を行うこと により結晶化させて成膜してもよい。また、導電性基板 がガラス基板に導電性薄膜を形成した基板の場合には、 CVD法により導電性薄膜上にアモルファスシリコンを 50 ばスパッタ法を用いてもよい。

10

成膜した後エキシマレーザでアニールすることにより、 ポリシリコン層を形成してもよい。また、導電性薄膜上 にポリシリコン層を形成する方法はCVD法に限定され るものではなく、例えばCGS (Continuous Grain S ilicon) 法や触媒CVD法などを用いてもよい。

【0031】ノンドーブのポリシリコン層3を形成した 後、55wt%のフッ化水素水溶液とエタノールとを略 1:1で混合した混合液よりなる電解液を用い、白金電 極 (図示せず) を負極、n 形シリコン基板 1 (オーミッ さは、具体的には10nmより小さいものがよく、好ま 10 ク電極2)を正極として、ポリシリコン層3に光照射を 行いながら定電流で陽極酸化処理を行うことによって、 多孔質ポリシリコン層4(以下、PPS層4と称す)が 形成され図2(b) に示すような構造が得られる。な お、本実施形態では、陽極酸化処理の条件として、電流 密度を10mA/cm'一定、陽極酸化時間を30秒と するとともに、陽極酸化中に500♥のタングステンラ ンプによりポリシリコン層3の表面に光照射を行った。 その結果、本実施形態では、膜厚が略1μmの多孔質ボ リシリコン層4が形成された。なお、本実施形態では、 ポリシリコン層3の一部を多孔質化しているが、ポリシ リコン層3全部を多孔質化してもよい。

> 【0032】次に、急速熱酸化(RTO:Rapid Therm al Oxidation)技術によってPPS層4及びポリシリ コン層3の急速熱酸化を行うことにより図2 (c)に示 す構造が得られる。ととに、図2(c)における5は急 速熱酸化されたポリシリコン層を、6は急速熱酸化され たPPS層 (以下、RTO-PPS層6と称す)を示 す。急速熱酸化の条件としては、酸化温度を900℃、 酸化時間を1時間とした。なお、本実施形態では、PP S層4及びポリシリコン層3の酸化を急速熱酸化により 行っているので、数秒で酸化温度まで昇温することが可 能であり、通常の炉心管タイプの酸化装置で問題となる 入炉時の巻き込み酸化を抑制することができる。また、 実施形態では、急速熱酸化技術によってPPS層 4 及び ポリシリコン層3を急速熱酸化しているが、急速熱酸化 に限らず、化学的方法により酸化してもよし、酸素プラ ズマにより酸化してもよい。また、酸化の替りに窒化す るようにしてもよく、窒化の場合には、窒素プラズマに よる窒化や熱的な窒化などの方法を用いればよい。

【0033】次に、RTO-PPS層6上に金属薄膜た る金薄膜7を例えば蒸着により形成することによって、 図2(d)(図1)に示す構造の電界放射型電子源10 が得られる。ととに、本実施形態では、金薄膜7の膜厚 を略10nmとしたが、この膜厚は特に限定するもので はない。なお、電界放射型電子源10は金薄膜7を電極 の正極 (アノード) とし、オーミック電極2を負極(カ ソード) とするダイオードが構成される。また、本実施 形態では、金属薄膜を蒸着により形成しているが、金属 薄膜の形成方法は蒸着に限定されるものではなく、例え

- . * . * .

11

【0034】以下、本実施形態の電界放射型電子源10 の特性について説明する。

【0035】上述の電界放射型電子源10を真空チャン バ(図示せず)内に導入して、図3に示すように金薄膜 7と対向する位置にコレクタ電極21(放射電子収集電 極)を配置し、真空チャンバ内の真空度を約5×10⁻¹ Paとして、金薄膜7とオーミック電極2との間に直流 電圧Vpsを印加するとともに、コレクタ電極21と金薄 膜7との間に直流電圧Vcを印加することによって、金 薄膜7とオーミック電極2との間に流れるダイオード電 10 流!psと、電界放射型電子源10から金薄膜7を通して 放射される電子e⁻(なお、図3中の一点鎖線は放射電 子流を示す)によりコレクタ電極21と金薄膜7との間 に流れる放出電子電流 I eとを測定した結果を図4に示 す。ことに、金薄膜7はオーミック電極2(つまり、n 形シリコン基板1)に対して正極として直流電圧Vpsを 印加し、コレクタ電極21は金薄膜7に対して正極とし て直流電圧Vcを印加している。

【0036】図4の横軸は直流電圧Vpsの値を、縦軸は 電流密度を示し、同図中のイ(○)がダイオード電流Ⅰ psを、同図中のロ(●)が放出電子電流 Leを示す。な お、直流電圧Vcは100V一定とした。

【0037】図4からも分かるように、放出電子電流Ⅰ eは直流電圧Vpsが正のときのみ観測され、直流電圧V psの値を増加させるにつれてダイオード電流 I ps及び放 出電子電流 I eとも増加した。例えば、直流電圧 V psを 15 Vとしたとき、ダイオード電流 I psの電流密度は略 100mA/cm¹、放出電子電流 Ieの電流密度は略1 0 μA/c m'であり、この放出電子電流 I eの値は従来 例で説明した単結晶シリコン基板の表面を多孔質化する ことにより実現される電界放射型電子源に比べて大きな 値であり(例えば、電子情報通信学会ED96-14 1, P41-46によれば、直流電圧Vpsを15Vとし たとき、ダイオード電流Ipsの電流密度は略40mA/ cm'、放出電子電流 I eの電流密度は略 1 μ A / c m' である)、本実施形態の電界放射型電子源10の電子の 放出効率が高いことが分かる。

【0038】図5に、この放出電子電流 I eと直流電圧 Vpsとに関するデータをFowler-Nordhei m(ファウラーノルドハイム)プロットした結果を示 す。図5より、各データが直線上にのることから、この 放出電子電流Ieは量子的なトンネル効果による電子の 放出による電流であると推考される。このときの電子放 出の機構を図6のエネルギバンド図により説明する。な お、図6中のn'-Siはn形シリコン基板1を、RT O-PPSは上述のRTO-PPS層6を、SiOxは RTO-PPS層6の最表面に形成された酸化シリコン 薄膜、Auは金薄膜7を、E,はフェルミレベルを、E vacは真空レベルを、それぞれ示す。また、図6(a)

流電圧V psを印加したときの状態を示す。金薄膜7をn 形シリコン基板 1 に対して正極として直流電圧 V psを印 加し、この直流電圧Vpsが所定値(臨界値)に達する と、図6(b)に示すように、n形シリコン基板1側か らRTO-PPS層6に熱的励起により電子e-が注入 される。このとき、直流電圧Vpsのほとんどは半絶縁性

12

のRTO-PPS層6にかかっているので、注入された 電子e-はRTO-PPS層6内に存在する強電界(平 均電界は略10'V/cm)によってドリフトされ、不 規則なポテンシャルや格子などの散乱により運動エネル ギを失いながら表面側に向かっていく(なお、この過程 では衝突電離による電子倍増もありうる)。RTO-P PS層6の表面に到達した電子e-は、熱平衡状態より も高い運動エネルギをもったいわゆるホットエレクトロ ン (熱い電子) と考えられ、電界効果によりRTO-P PS層6の最表面のSiOxのサブバンドを介して金薄

膜7を容易にトンネルし外部に放出されるものと推考さ

【0039】この理論を確認するために、本実施形態の 電界放射型電子源10から放射される電子のエネルギN (E) のエネルギ分布を測定した結果を図7に示す。図 7において、イは直流電圧Vpsを12Vとした場合、ロ は直流電圧Vpsを15Vとした場合、ハは直流電圧Vps を18 V とした場合、をそれぞれ示す。図7から、電子 のエネルギN(E)のエネルギ分布は比較的ブロードで あって、しかも数eVの高エネルギ成分を含んでおり、 印加する直流電圧Vpsの増加とともにピーク位置が高エ ネルギ側へシフトすることがわかった。したがって、R TO-PPS層6での電子散乱は少なく、RTO-PP S層6の表面側に到達した電子は十分なエネルギを有す るホットエレクトロンであると考えられる。なお、図6 中の二点鎖線で示した円A内の図は、放出直前の電子の エネルギ分布n(E)とトンネル放出確率T(E)との 関係を定性的に示したものであり、放出電子のエネルギ N (E) のエネルギ分布の形状はn (E) とT (E) と の乗算により決まる(N(E)=n(E)T(E))。 例えば、直流電圧Vpsの電圧が増加すると、n(E)は 髙エネルギ側のテール成分が増えるように変化し、その 結果としてN(E)も全体的に高エネルギ側へシフトす

【0040】なお、熱平衡状態にまで緩和してしまう強 い散乱を電子が受けていないということは、RTO-P PS層6内でのエネルギ損失、すなわち、熱的なロスが 少ないということを意味し、放出電子電流 Ieの効率が 髙く安定して電子を放出することができると考えられ る。図8は本実施形態の電界放射型電子源10のダイオ ード電流 I psおよび放出電子電流 I eそれぞれの経時変 化を示すグラフであって、横軸が時間、縦軸が電流密度 であり、同図中のイがダイオード電流Ipsを、同図中の は直流電圧Vpsの印加前の状態を示し、図6(b)は直 50 口が放出電子電流 leを示す。なお、図8は、直流電圧

ン基板1 (抵抗率が略0. 1Ωcmの(100)基板) を用いている。

【0044】まず、n形シリコン基板1の裏面にオーミ ック電極2を形成した後、n形シリコン基板1の表面に 膜厚が略 1. 5 μmのノンドープのポリシリコン層 3 を 形成することにより図10(a)に示すような構造が得 られる。

【0045】次に、55wt%のフッ化水素水溶液とエ タノールとを略1:1で混合した混合液よりなる電解液 を用い、白金電極(図示せず)を負極、 n 形シリコン基 板1(オーミック電極2)を正極として、ポリシリコン 層3に光照射を行いながら定電流で陽極酸化処理を行 う。とこにおいて、陽極酸化処理は次の手順で行った。 陽極酸化処理の条件として、電流密度を2.5mA/c m'一定、陽極酸化時間を4秒とする第1の条件と、電 流密度を20mA/cm゚一定、陽極酸化時間を5秒と する第2の条件とを設定し、第1の条件での陽極酸化処 理と第2の条件での陽極酸化処理とを交互に3回繰り返 して行った。但し、陽極酸化中には500♥のタングス 20 テンランプにより表面に光を照射することとした。ここ で、第1の条件での陽極酸化が終了した時点では、ポリ シリコン層3の表面側に多孔度の低い多孔質ポリシリコ ン層4a(以下、PPS層4aと称す)が形成され図1 0 (b) に示すような構造が得られる。その後、第2の 条件での陽極酸化が終了した時点では、上記多孔質ポリ シリコン層4aよりもn形シリコン基板1側に、PPS 層4aよりも多孔度の高い多孔質ポリシリコン層4b (以下、PPS層4bと称す)が形成され図10(c) に示すような構造が得られる。しかして、第1の条件、 第2の条件での陽極酸化が3回ずつ終了した時点では、 PPS層4aとPPS層4bとが交互に積層された図1 1 (a) に示す構造が得られる。なお、本実施形態で は、PPS層4aとPPS層4bとの積層構造よりなる 多孔質ポリシリコン層の膜厚は略 1 µmであった。ま た、本実施形態では、ポリシリコン層3の一部を多孔質 化しているが、ポリシリコン層3全部を多孔質化しても よい。

【0046】次に、急速熱酸化(RTO:Rapid Therm al Oxidation) 技術によって全てのPPS層4a, 4 b及びポリシリコン層3の急速熱酸化を行うことにより 図11(b)に示す構造が得られる。 ととに、図11 (b) における5は急速熱酸化されたポリシリコン層 を、6a,6bは急速熱酸化された上記多孔質ポリシリ コン層 (以下、RTO-PPS層6a, 6bと称す)を 示す。急速熱酸化の条件としては、酸化温度を900 °C、酸化時間を1時間とした。なお、本実施形態では、 PPS層4a.4b及びポリシリコン層3の酸化を急速 熱酸化により行っているので、数秒で酸化温度まで昇温 することが可能であり、通常の炉心管タイプの酸化装置 も、実施形態1と同様に、導電性基板としてn形シリコ 50 で間題となる入炉時の巻き込み酸化を抑制することがで

Vpsを15V一定、直流電圧Vcを100V一定とした 場合の結果である。図8からわかるように、本実施形態 の電界放射型電子源10では、ダイオード電流Ips、放 出電子電流Ie両方ともポッピング現象は観測されず、 時間が経過しても略一定のダイオード電流Ips及び放出 電子電流Ieを維持することができる。これは、RTO -PPS層6は各グレインの表面が多孔質化し各グレイ ンの中心部分では結晶状態が維持されており、電圧の印 加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝 導して外部に放出され、温度上昇が抑制されるからであ 10 ると推考される。このような放出電子電流Ieの経時変 化の少ない安定した特性は、従来のMIM方式や単結晶 シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現され る電界放射型電子源では得られない特性であり、本発明 の構造を採用することにより得られる特性である。

【0041】次に、本実施形態の電界放射型電子源10 の放出電子電流 I eの真空度依存性について説明する。 図9は本実施形態の電界放射型電子源10の周囲をAr ガス雰囲気として真空度を変化させたときのダイオード 電流Ips及び放出電子電流Ieの変化を示す。図9は横 軸が真空度、縦軸が電流密度であり、同図中のイ(○) がダイオード電流 I psを、同図中のロ(●)が放出電子 電流 I eを示す。図9から、真空度が約10つPa~約 1Paの範囲では略一定の放出電子電流 Ieが得られ、 放出電子電流Ieの真空度依存性が小さいことがわか る。すなわち、本実施形態の電界放射型電子源10は電 子放出特性の真空度依存性が小さいので、真空度が多少 変化しても安定して電子を効率良く放出(放射)するこ とができ、低真空度でも良好な電子放出特性が得られ従 来のような高真空で使用する必要がないから、電界放射 30 型電子源10を利用する装置の低コスト化が図れるとと もに取扱いが容易になる。

【0042】本実施形態では、導電性基板としてn形シ リコン基板 1 (抵抗率が略 0. 1Ωcmの(100)基 板)を用いているが、導電性基板は n 形シリコン基板に 限定されるものではなく、例えば、金属基板や、ガラス 基板などに透明導電性薄膜(例えば、ITO: Indium Tin Oxide) や白金やクロムなどの導電性膜を形成した 基板などを用いてもよく、n形シリコン基板などの半導 体基板を用いる場合に比べて大面積化及び低コスト化が 40 可能になる。

【0043】(実施形態2)本実施形態の電界放射型電 子源10の基本構成は図1に示した実施形態1と略同じ でなので図示を省略し、製造方法を図10及び図11を 参照しながら説明する。本実施形態では、実施形態1に おける多孔質ポリシリコン層6が、図11(c)に示す ように多孔度の高いポリシリコン層6 bと多孔度の低い ポリシリコン層6aとが交互に積層された層により構成 されている点が相違する。なお、本実施形態において

きる。

【0047】その後、最上層のRTO-PPS層6a上 に金属薄膜たる金薄膜7を例えば蒸着により形成すると とによって、図11(c)に示す構造の電界放射型電子 源10が得られる。ととに、本実施形態では、金薄膜7 の膜厚を略10nmとしたが、この膜厚は特に限定する ものではない。なお、電界放射型電子源10は金薄膜7 を電極の正極(アノード)とし、オーミック電極2を負 極(カソード)とするダイオードが構成される。

【0048】以下、本実施形態の電界放射型電子源10 10 の特性について説明する。

【0049】上述の電界放射型電子源10を真空チャン バ(図示せず)内に導入して、実施形態1と同様、図3・ に示すように金薄膜7と対向する位置にコレクタ電極2 1 (放射電子収集電極)を配置し、真空チャンバ内の真 空度を約5×10⁻¹Paとして、金薄膜7とオーミック 電極2との間に直流電圧V psを印加するとともに、コレ クタ電極21と金薄膜7との間に直流電圧Vcを印加す ることによって、金薄膜7とオーミック電極2との間に 流れるダイオード電流 I psと、電界放射型電子源 10か 20 ら金薄膜7を通して放射される電子e⁻(なお、図3中 の一点鎖線は放射電子流を示す)によりコレクタ電極2 1と金薄膜7との間に流れる放出電子電流 I eとを測定 した結果を図12に示す。ここに、金薄膜7はオーミッ ク電極2 (つまり、n形シリコン基板1)に対して正極 として直流電圧Vpsを印加し、コレクタ電極21は金薄 膜7に対して正極として直流電圧Vcを印加している。 【0050】図12の横軸は直流電圧Vpsの値を、縦軸 は電流密度を示し、同図中のイ(〇)がダイオード電流

【0051】図12からも分かるように、本実施形態に おいても実施形態1同様、放出電子電流leは直流電圧 Vpsが正のときのみ観測され、直流電圧Vpsの値を増加 させるにつれてダイオード電流Ips及び放出電子電流I eとも増加した。例えば、直流電圧Vpsを15Vとした とき、ダイオード電流 I psの電流密度は略 1 m A / c m ²、放出電子電流 Ieの電流密度は略4 μA/cm²であ り、この放出電子電流Ieの値は従来例で説明した単結 晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより実現さ れる電界放射型電子源(特開平8-250766号公報 参照) に比べて大きな値であり (例えば、電子情報通信 学会ED96-141, P41-46によれば、直流電 圧Vpsを15Vとしたとき、ダイオード電流 1psの電流 密度は略40mA/cm゚、放出電子電流 1 eの電流密度 は略1 µ A/c m²である)、本実施形態の電界放射型 電子源の電子の放出効率が高いことが分かる。

Ipsを、同図中のロ(●)が放出電子電流 Ieを示す。

なお、直流電圧Vcは100V一定とした。

【0052】図13に、この放出電子電流 Ie と直流電 圧Vpsとに関するデータをFowler-Nordhe

す。図13より、各データが直線上にのることから、こ の放出電子電流 I eは実施形態 1 と同様に、量子的なト ンネル効果による電子の放出による電流であると推考さ れる。

【0053】図14は本実施形態の電界放射型電子源1 0のダイオード電流 I psおよび放出電子電流 I eそれぞ れの経時変化を示すグラフであって、横軸が時間、縦軸 が電流密度であり、同図中のイがダイオード電流Ips を、同図中の口が放出電子電流 leを示す。なお、図1 4は、直流電圧Vpsを21V一定、直流電圧Vcを10 0 V ─定とした場合の結果である。図14から分かるよ うに、本実施形態の電界放射型電子源10においても、 実施形態 1 と同様、ダイオード電流 I ps、放出電子電流 Ie両方ともポッピング現象は観測されず、時間が経過 しても略一定のダイオード電流Ips及び放出電子電流I eを維持することができる。このような放出電子電流 le の経時変化の少ない安定した特性は、従来のMIM方式 や単結晶シリコン基板の表面を多孔質化することにより 実現される電界放射型電子源では得られない特性であ り、本発明の構造を採用することにより得られる特性で

【0054】なお、上述の陽極酸化処理の条件として は、次のような条件で行ってもよい。すなわち、図15 に示すように、電流密度を0mA/cm²として陽極酸 化を開始し、20秒間で電流密度を0mA/cm2から 20mA/cm'まで増加させる途中で、電流密度を2 秒間だけ2.5mA/cm'とする期間を3回設けるよ うにしてもよい。但し、陽極酸化中には500₩のタン グステンランプにより表面に光を照射することは勿論で 30 ある。この場合には、電流密度を2.5 m A / c m² と した期間に多孔度の低い多孔質ポリシリコン層4 aが形 成されるととになる。

【0055】(実施形態3)本実施形態の電界放射型電 子源10の基本構成は図1に示した実施形態1と略同じ でなので図示を省略し、製造方法を図16を参照しなが ら説明する。本実施形態は、実施形態1における多孔質 のポリシリコン層6が、厚み方向に多孔度が連続的に変 化した層である点に特徴がある。なお、本実施形態にお いても、実施形態1と同様に、導電性基板としてn形シ リコン基板1 (抵抗率が略0. 1Ωcmの(100)基 板)を用いている。

【0056】まず、n形シリコン基板1の裏面にオーミ ック電極2を形成した後、n形シリコン基板1の表面に 膜厚が略1.5μmのノンドープのポリシリコン層3を 形成することにより図16(a)に示すような構造が得 **られる。**

【0057】次に、55wt%のフッ化水素水溶液とエ タノールとを略1:1で混合した混合液よりなる電解液 を用い、白金電極(図示せず)を負極、n形シリコン基 im(ファウラーノルドハイム)プロットした結果を示 50 板1(オーミック電極2)を正極として、ポリシリコン

1. T. F. 14

てある。したがって、電界放射型電子源10から電子を放射させることによって、蛍光体32を発光させることができ、蛍光体32の発光を透明電極31及び透明板33を通して外部に表示することができる。

18

【0062】本実施形態の平面発光装置において、透明 電極31を金薄膜7に対して正極とし透明電極31と金 薄膜7との間に1kVの直流電圧Vcを印加した状態 で、電界放射型電子源10の金薄膜7とオーミック電極 2との間に15V程度の直流電圧Vpsを印加して電子を 10 放出(放射)させたところ、金薄膜7の面積(サイズ) に対応する蛍光パターンが得られた。これは、電界放射 型電子源10から放射される放出電子電流 I 密度が金 薄膜7の面内で略均一であることを示すとともに、放射 される電子 e⁻が金薄膜7から略垂直方向に放射され、 電子 e⁻の流れが拡がったり狭まったりすることなく略 平行となっていることを示す証左である。したがって、 本実施形態では、電子 e⁻が金薄膜7の面内で略均一に 略垂直方向へ放射されるから、従来の平面発光装置で用 いられる収束電極を設ける必要がなく、構造が簡単にな るとともに低コスト化が可能になる。また、電界放射型 電子源10からの電子の放出時にポッピング現象が発生 しないので、表示むらを少なくすることができる。

【0063】(実施形態5)図18に実施形態1ないし実施形態3のいずれかに記載の電界放射型電子源10をディスプレイ装置に利用する場合の電子源部の概略構成図を示す。本実施形態では、図18に示すように、実施形態1ないし実施形態3のいずれかに記載の電界放射型電子源10をマトリクス状(アレイ状)に構成し、各電界放射型電子源10を各ピクセルに対応させてあり、Xマトリクスコントロール回路41とYマトリクスコントロール回路42とで各電界放射型電子源10に印加する上述(実施形態1で説明)の直流電圧Vpsをそれぞれオンオフするようになっている。すなわち、本実施形態では、Xマトリクスコントロール回路41とYマトリクスコントロール回路42とによって直流電圧Vpsを印加する電界放射型電子源10を選択するようになっており、選択された電界放射型電子源10からのみ電子が放射される

【0064】なお、本実施形態のディスプレイ装置では、図示しないが、実施形態4と同様に、電子源部に対向配置される(つまり、電界放射型電子源10の金薄膜7に対向配置される)透明電極を備え、透明電極には電界放射型電子源10から放射される電子線により可視光を発光する蛍光体が塗布してある。また、透明電極はガラス基板などの透明板に塗布形成してある。

層3 に光照射を行いながら定電流で陽極酸化処理を行う。とこにおいて、陽極酸化処理は、電流密度を0 m A / c m² として陽極酸化を開始し、時間経過とともに電流密度を0 m A / c m² をで連続的に、時間を過去ともに電流密度を0 m A / c m² から20 m A / c m² まで連続的に、(徐々に)増加させる。但し、陽極酸化中には500 Wのタングステンランプにより表面に光を照射することとした。しかして、陽極酸化処理が終了した時点では、n 形シリコン基板1に近い側が高多孔度で表面に近い方が低多孔度となり多孔度が厚み方向に連続的に変化した多孔質ポリシリコン層4c(以下、P P S 層4 c と称す)が形成され図16(b)に示すような構造が得られる。なお、本実施形態では、P P S 層4 c の膜厚は略1 μ m であった。また、本実施形態では、ポリシリコン層3 全部を多孔質化してもよい。

【0058】次に、急速熱酸化技術によってPPS層4 c及びポリシリコン層3の急速熱酸化を行い(急速熱酸化の条件としては、酸化温度を900℃、酸化時間を1時間とした)、金属薄膜たる金薄膜7を例えば蒸着により形成することによって、図16(c)に示す構造の電 20界放射型電子源10が得られる。ここに、本実施形態では、金薄膜7の膜厚を略10nmとしたが、この膜厚は特に限定されるものではない。なお、電界放射型電子源10は金薄膜7を電極の正極(アノード)とし、オーミック電極2を負極(カソード)とするダイオードが構成される。また、図16(c)において、5は急速熱酸化されたポリシリコン層を、6は急速熱酸化されたPPS層4c(RTO-PPS層6)を示す。

【0059】なお、本実施形態では、陽極酸化処理において電流密度を徐々に増加させることにより多孔度を変 30 化させているが、電流密度を徐々に減少させることにより多孔度を変化させるようにしてよく、後者の場合には、n形シリコン基板1に近い側が低多孔度で表面に近い方が高多孔度となる。

【0060】(実施形態4)図17に実施形態1の電界放射型電子源10を利用した平面発光装置の概略構成図を示す。なお、実施形態1と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略する。ここにおいて、電界放射型電子源10としては、実施形態2または実施形態3の電界放射型電子源10を用いてもよい。

【0061】本実施形態の平面発光装置は、電界放射型電子源10と、電界放射型電子源10の金薄膜7に対向配置される透明電極31を備え、透明電極31には電界放射型電子源10から放射される電子線により可視光を発光する蛍光体32が塗布してある。また、透明電極31はガラス基板などの透明板33に塗布形成してある。ことに、透明電極31及び蛍光体32が形成された透明板33はスペーサ34を介して電界放射型電子源10と一体化してあり、透明板33とスペーサ34と電界放射型電子源10とで囲まれる内部空間を所定の真空度にし

せることができる。したがって、従来のような複雑なシャドウマスクを設ける必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現することが可能となる。

19

【0066】(実施形態6)図19に実施形態1に記載の電界放射型電子源10を利用した固体真空デバイスの 概略構成図を示す。なお、実施形態1と同様の構成要素 については同一の符号を付し説明を省略する。また、電 界放射型電子源10としては実施形態2または実施形態 3の構造を採用してもよい。

【0067】本実施形態の固体真空デバイスは、三極管 10 タイプのものであって、電界放射型電子源10をカソードとし、電界放射型電子源10の金薄膜7に対向してアノード電極51(陽極)を配置し、アノード電極51とカソードとの間にメッシュ状のグリッド52を設けてある。また、アノード電極51、グリッド52、カソードは封止材53、54によって真空封止されている。なお、本実施形態では、封止材53、54とn形シリコン基板1よりなる導電性基板とで真空容器を構成している。

【0068】本実施形態の固体真空デバイスは、電界放 20 射型電子源10に上述の直流電圧Vpsを印加することにより電界放射型電子源10、つまりカソードから電子が放射され、アノード電極51と金薄膜7との間に印加されるアノード電圧Vakにより加速されるので、アノード電極51とカソードとの間にアノード電流Iaが流れる。なお、このアノード電流Iaの大きさは、グリッド52を負極としてグリッド52とオーミック電極2との間に印加する直流電圧Vgの値を変化させることにより制御できる。

【0069】従来の真空デバイスは熱電子放射を用いた 30 陰極が主流であるが、本発明の電界放射型電子源を用い れば、冷陰極で長寿命の固体真空デバイスを実現するこ とができる。

【0070】なお、本実施形態では三極管タイプの固体 真空デバイスについて説明したが、多極管タイプであっ てもよいことは勿論である。

[0071]

【発明の効果】請求項1の発明は、導電性基板と、導電性基板の一表面側に形成され酸化されたナノメータ単位の構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポリシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加することにより金属薄膜を通して電子線を放射するものであって、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維持されているものであり、電圧の印加により生じた熱が上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出されて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生せず安定して高効率で電子を放出することができ、ま50

た、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体 基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板な どを使用することもできるから、従来のように半導体基 板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピ ント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化 が可能になるという効果がある。

【0072】請求項2の発明は、導電性基板と、導電性 基板の一表面側に形成され窒化されたナノメータ単位の 構造を有する多孔質のポリシリコン層と、該多孔質のポ リシリコン層上に形成された金属薄膜とを備え、金属薄 膜を導電性基板に対して正極として電圧を印加すること により金属薄膜を通して電子線を放射するものであっ て、上記多孔質のポリシリコン層は、各グレインの表面 が多孔質化され各グレインの中心部分では結晶状態が維 持されているものであり、電圧の印加により生じた熱が 上記結晶状態が維持された部分を伝導して外部に放出さ れて温度上昇が抑制されるので、電子放出特性の真空度 依存性が小さく且つ電子放出時にポッピング現象が発生 せず安定して髙効率で電子を放出することができ、ま た、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体 基板の他にガラス基板などに導電性膜を形成した基板な どを使用することもできるから、従来のように半導体基 板を多孔質化した多孔質半導体層を利用する場合やスピ ント型電極に比べて、電子源の大面積化及び低コスト化 が可能になるという効果がある。

【0073】請求項6の発明は、請求項1乃至請求項5の発明において、上記ポリシリコン層が、ノンドーブのポリシリコン層なので、酸化または窒化された多孔質のポリシリコン層が半絶縁性となり、上記電圧を印加することにより該多孔質のポリシリコン層が強電界となって、導電性基板側から該多孔質のポリシリコン層に注入された電子がドリフトして該多孔質のポリシリコン層の表面に達し、ホットエレクトロンとして金属薄膜をトンネルすることにより電子が放射されるから、上記ポリシリコン層がドーピングされている場合に比べて高効率で安定して電子を放出することができ、また、ドービングが不要なので製造が容易になるという効果がある。

【0074】請求項7の発明は、請求項1乃至請求項6の発明において、導電性基板は、一表面に導電性薄膜が 形成された基板からなるので、導電性基板として単結晶シリコン基板などの半導体基板を用いる場合に比べて大面積化及び低コスト化が可能になるという効果がある。 [0075]請求項8の発明は、請求項1記載の電界放射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシリコン層を形成し、ボリシリコン層を多孔質化し、多孔質化されたポリシリコン層を酸化し、酸化された多孔質のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成するので、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによ って電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界

1 T .

21

放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電 界放射型電子源を提供することができるという効果があ

【0076】請求項9の発明は、請求項2記載の電界放 射型電子源の製造方法であって、導電性基板上にポリシ リコン層を形成し、ポリシリコン層を多孔質化し、多孔 質化されたポリシリコン層を窒化し、窒化された多孔質 のポリシリコン層上に金属薄膜よりなる電極を形成する ので、従来のスピント型電極のような複雑な構造や製造 プロセスを必要とせず、比較的簡単な製造プロセスによ 10 って電子を安定して高効率で放出できる低コストの電界 放射型電子源を提供することができ、また、大面積の電 界放射型電子源を提供することができるという効果があ

【0077】請求項12の発明は、請求項1乃至請求項 7のいずれかに記載の電界放射型電子源と、上記金属薄 膜に対向配置される透明電極とを備え、上記電子線によ り可視光を発光する蛍光体が上記透明電極に設けられて いるので、電界放射型電子源から放射される電子の放出 角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそろうか ら、収束電極を設ける必要がなく、構造が簡単になると ともに薄型の平面発光装置を実現することができるとい う効果がある。

【0078】請求項13の発明は、請求項1乃至請求項 7のいずれかに記載の電界放射型電子源をマトリクス状 に構成し、各電界放射型電子源に印加する上記電圧をそ れぞれ制御する手段と、上記金属薄膜に対向配置される 透明電極とを備え、上記電子線により可視光を発光する 蛍光体が上記透明電極に設けられて成ることを特徴とす るものであり、電界放射型電子源から放射される電子の 30 放出角度が金属薄膜の表面に対して略垂直方向にそろう ので、複雑なシャドウマスクや電子収束レンズを設ける 必要がなく、高精細なディスプレイ装置を実現すること ができるという効果がある。

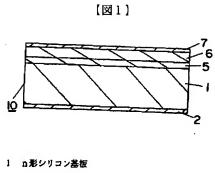
【0079】請求項14の発明は、少なくとも請求項1 乃至請求項7のいずれかに記載の電界放射型電子源と陽 極とが真空容器中に配設されているので、電界放射型電 子源が冷陰極を構成するから、従来の熱電子放射を利用 した熱陰極を有する固体真空デバイスのように加熱手段 を設ける必要がなく、小型化が可能になるとともに陰極 40 10 電界放射型電子源 22

物質の蒸発や劣化を抑制することができ、長寿命の固体 真空デバイスを実現することができるという効果があ

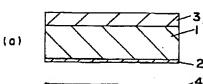
【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施形態1を示す断面図である。
- 【図2】同上の製造プロセスを説明するための主要工程 断面図である。
- 【図3】同上の放射電子の測定原理の説明図である。
- 【図4】同上の電圧電流特性図である。
- 【図5】図4のデータをFowler-Nordhei mプロットしたグラフである。
 - 【図6】同上の電子放出機構を説明するバンド図であ
 - 【図7】同上の放出電子のエネルギ分布の説明図であ
 - 【図8】同上の電流の経時変化を示すグラフである。
 - 【図9】同上の電流の真空度依存性を示すグラフであ
- 【図10】実施形態2の製造プロセスを説明するための 主要工程断面図である。
- 【図11】同上の製造プロセスを説明するための主要工 程断面図である。
- 【図12】同上の電圧電流特性図である。
- 【図13】図12のデータをFowler-Nordh e i mプロットしたグラフである。
- 【図14】同上の電流の経時変化を示すグラフである。
- 【図15】同上の他の構成例の陽極酸化処理の説明図で
- 【図16】実施形態3の製造プロセスを説明するための 主要工程断面図である。
- 【図17】実施形態4を示す概略構成図である。
- 【図18】実施形態5を示す要部概略構成図である。
- 【図19】実施形態6を示す概略構成図である。 【符号の説明】
- 1 n形シリコン基板
- 2 オーミック電極
- 5 急速熱酸化されたポリシリコン層
- 6 急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層
- 7 金薄膜

1. T. .

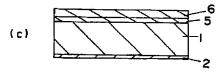


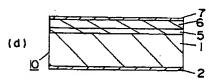
- 2 オーミック電極
- 5 急速熱酸化されたポリシリコン層
- 8 急速熱酸化された多孔質ポリシリコン層
- 7 全障膜
- 10 医界放射型電子源

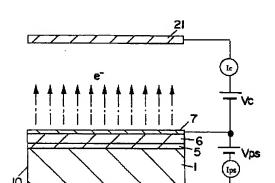


[図2]

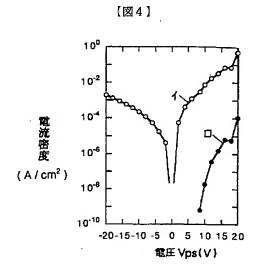




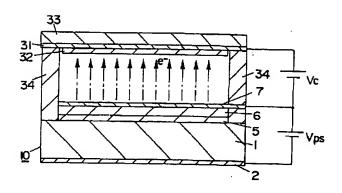


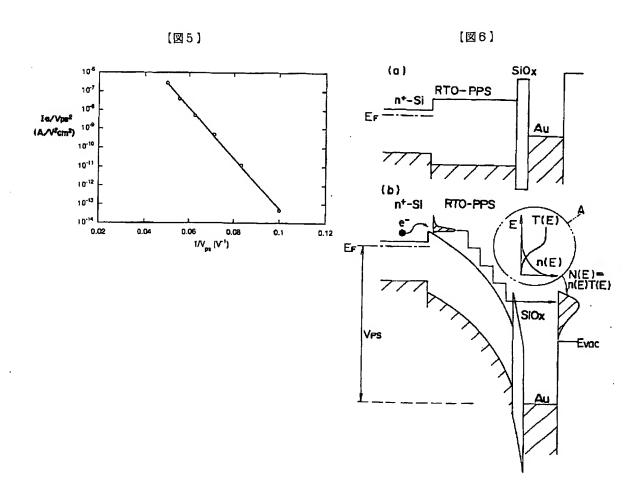


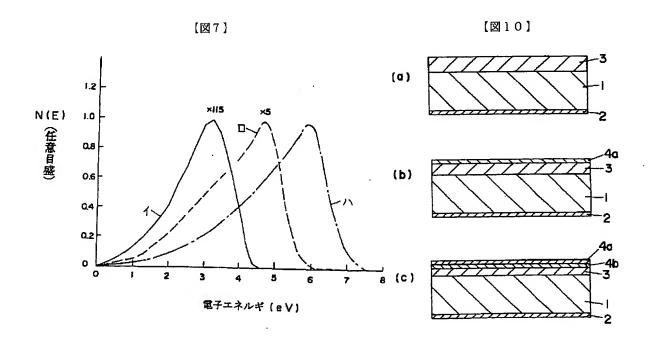
[図3]

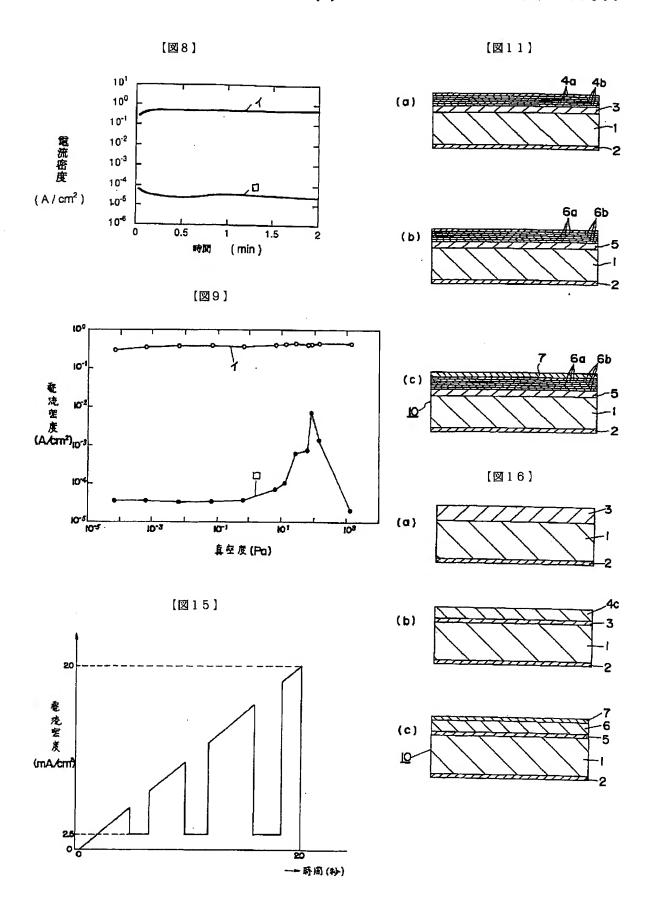


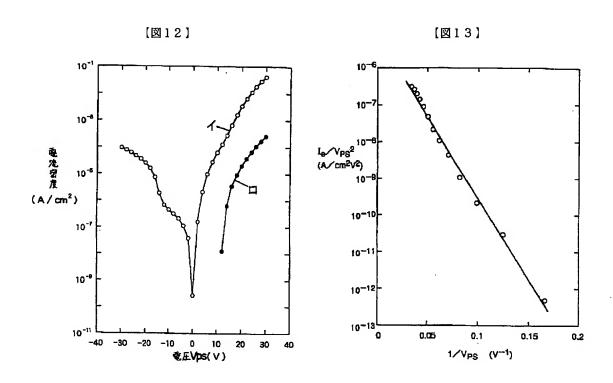
【図17】

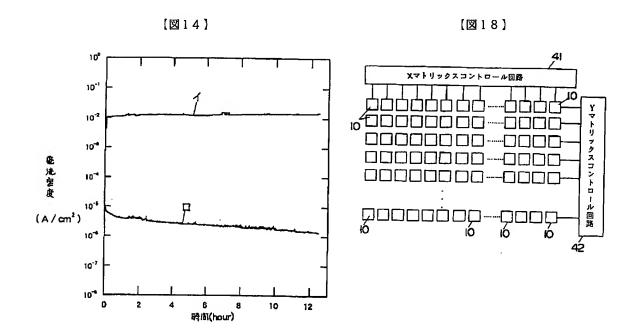




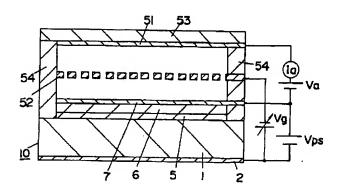








【図19】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

HO1J 31/12

FΙ

H 0 1 J 31/12

С

(56)参考文献 特開 平9-259795 (JP, A)

特開 平10-269932 (JP, A)

Xia Sheng at a

l., "Properties of

Porous Silicon EL Diodes as Surface-

Emitting Cold Cath

ode(IV)",第44回応用物理関係

連合講演会予稿集,平成9年3月, 29p

- Y 12

(58)調査した分野(Int.Cl.*, DB名)

H01J 1/30

HO1J 9/02

H01J 19/24

H01J 21/10

HO13 29/04

HO1J 31/12

JICSTファイル (JOIS)